

Suporte Circular Para Wafers De Ptfе De 6 Polegadas Resistente A Ácidos E Álcalis Cesta De Limpeza Para Semicondutores Personalizável

Número do item: PL-CP207



introdução

Suportes circulares para wafers de PTFE de 6 polegadas de alta pureza, projetados para limpeza de semicondutores. Excelente resistência a ácidos e álcalis para limpeza piranha e etching com HF. Cestas usinadas com precisão e totalmente personalizáveis garantem o manuseio seguro de substratos durante rigorosos processos químicos úmidos, banhos de imersão e enxágue ultrassônico.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Processo de Limpeza RCA	Usado para remover resíduos orgânicos, finas camadas de óxido e contaminação iônica de wafers de silício usando soluções SC-1 e SC-2.	Alta resistência térmica e química previne degradação do transportador durante imersão em banho aquecido.
Etching Piranha	Manuseio de wafers em uma mistura de ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio para remover matéria orgânica pesada.	Resistência excepcional a ambientes oxidativos agressivos garante longa vida útil do equipamento.
Imersões em Ácido Fluorídrico (HF)	Remoção de camadas de óxido sacrificiais ou óxidos nativos de superfícies de silício em várias concentrações de HF.	A pureza do material previne a introdução de íons metálicos no ambiente de etching sensível.
Enxágue Pós-CMP	Transporte de wafers através de ciclos de limpeza após o Polimento Químico-Mecânico para remover partículas de slurry.	Superfícies lisas e antiaderentes previnem o aprisionamento de partículas e facilitam a limpeza ultrassônica eficaz.
Fabricação de Células Solares	Processamento de wafers de silício monocristalino ou policristalino de 6 polegadas durante etapas de texturização e difusão de fósforo.	Construção robusta suporta alto volume de produção em linhas de produção industrial exigentes.
Fotolitografia	Suporte a substratos durante o desenvolvimento e remoção de fotoresist usando solventes e removedores especializados.	Compatibilidade universal com solventes previne inchamento ou amolecimento da estrutura do transportador.
Limpeza Ultrassônica	Transporte de componentes delicados em banhos ultrassônicos ou megassônicos para remoção de alta precisão de contaminantes.	Rigidez estrutural permite transmissão eficiente de energia acústica para as superfícies dos wafers.
Etching de Semicondutores Compostos	Processamento de wafers de GaAs, InP ou SiC em misturas químicas especializadas para fabricação de dispositivos optoeletrônicos.	Geometria de ranhura personalizável acomoda várias espessuras de wafer e materiais de substrato frágeis.

Parâmetro	Detalhe da Especificação para PL-CP207
Identificador do Modelo	PL-CP207
Construção do Material	PTFE Virgem de Alta Pureza (Opções personalizadas em PFA disponíveis)
Compatibilidade com Tamanho de Wafer	6 Polegadas / 150mm de Diâmetro
Configuração Geométrica	Cesta de Limpeza Circular / Tipo Cesta Flor
Compatibilidade Química	Resistência universal (Ácidos, Bases, Solventes, Oxidantes)
Tolerância de Temperatura	Adequado para processamento criogênico até alta temperatura

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Parâmetro	Detalhe da Especificação para PL-CP207	
Capacidade de Personalização	Dimensões, número de ranhuras e configurações de alça totalmente personalizáveis	
Acabamento Superficial	Usinado com precisão, ultra liso, não poroso	
Capacidade do Lote	Projetado sob medida para os requisitos específicos de quantidade de wafers do cliente	
Método de Fabricação	Usinagem CNC Sob Medida / Fabricação Personalizada	